|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GSIE 2021 组团参观回执表** | | | | | | | | |
| \*单位名称 |  | | | | | | | |
| \*联 系 人 |  | \*部 门 | |  | | \*职 务 | |  |
| \*手 机 |  | \*电 话 | |  | | \*邮 箱 | |  |
| \*身份证件 |  | \*户籍所在地 | |  | | \*长住所在地 | |  |
| 参观目的 | □ 采购产品 □ 与业务伙伴会面 □ 寻求合作  □ 收集信息，产品比较 □ 了解技术动态 □ 其他 | | | | | | | |
| 感兴趣  展区 | **半导体产业展区**  □ 集成电路制造  □ 封装测试  □ 半导体材料  □ 生产设备（二手设备）  □ 人才计划培训交流  □ 电子元器件  □ AI+IOT+5G  □ 微波毫米及射频技术  □ 电源 | | | | **电子生产设备展区**  □ 3C机器人及智能工厂  □ 自动化设备及材料  □ ESD防静电和净化设备  □ 激光设备及其材料  □ 测试与测量  □ 机器视觉系统及组件  □ 生产物流和物流技术  □ 线束和连接器生产技术  □ SMT周边设备  □ PCBA制造  □ 点胶注胶 | | | |
| \*采购产品 |  | 计划采购数量 | | |  | \*采购预算 | |  |
| \*产品规格 |  | | | | | | | |
| 同期参会 | **第三届未来半导体产业发展大会**  □主会场  □集成电路设计技术论坛 □先进封装与测试技术论坛  □智能化数字电源设计论坛 □AI+5G+IOT论坛  □半导体创新材料以及设备论坛 □半导体与汽车智能网联技术论坛  □半导体创新投资发展论坛 □新技术、新产品推介会 | | | | | | | |
| 预计共( )人前往参观，请填写随同人员或另附参观人员名单，10人以上参观团享专属服务。 | | | | | | | | |
| 姓名 | 部门 | 职务 | 手机 | | | | E-mail | |
|  |  |  |  | | | |  | |
| **注：填好之后请回传至邮箱GSIECQ@163.com 参观咨询：韩女士 18875157024** | | | | | | | | |